ET 200MP / S7-1500 Novità I/O

15.09.2020

Alcune interessanti novità per il sistema I/O ET 200MP/S7-1500.

Sono stati rilasciati i **moduli** a **64 canali digitali**:

- alta densità di canali con ingombro minimo (**35 mm**)
- miglior scalabilità grazie al **modulo misto 32DI/32DQ**
- cablaggio semplice e flessibile tramite **SIMATIC TOP connect**
- usabilità ottimizzata grazie ai **LED** direttamente sui moduli di collegamento

I nuovi moduli sono particolarmente utili in tutte quelle applicazioni dove è necessario un alto numero di ingressi/uscite digitali, in uno spazio ridotto.

Questi i modelli disponibili:

DI 64x24VDC SNK/SRC BA	**6ES7521-1BP00-0AA0**
DQ 64x24VDC/0.3A BA	**6ES7522-1BP00-0AA0**
DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA	**6ES7522-1BP50-0AA0**
DI 32x24VDC SNK/SRC / DQ32x24VDC/0.3A SNK BA	**6ES7523-1BP50-0AA0**

Per collegare al modulo i segnali dal campo, vengono utilizzati i componenti della serie **SIMATIC Top Connect**; per ogni modulo a 64 canali devono essere ordinati, separatamente, due cavi e due moduli di collegamento. I due cavi possono avere anche lunghezza diversa tra loro, a seconda delle necessità di installazione.

I diversi moduli di collegamento permettono di trovare la soluzione tecnica ed economica ottimale per ogni applicazione; le principali differenze tra le versioni disponibili sono:

- Morsetti a vite o push-in
- Con o senza LED
- Collegamenti 1-filo / 3-fili
- Sourcing o sinking input/output

Per la corretta selezione degli accessori, si consiglia l'utilizzo di "**TIA Selection Tool**", disponibile a questo link; i wizard del tool assistono l'utente nella selezione degli accessori, generando automaticamente le liste dei codici di ordinazione.

ET 200MP / S7-1500 Novità I/O

15.09.2020

Per un'ulteriore ottimizzazione delle configurazioni I/O, aumenta anche la densità di canali per i **moduli analogici**, grazie al rilascio di due moduli da **16 ingressi**, sempre con larghezza standard **35mm**:

modulo **AI 16xI BA** (**6ES7531-7MH00-0AB0**)
16 ingressi con range di misura 0..20mA, 4..20mA, ±20mA; risoluzione 16 bit

modulo **AI 16xU BA** (**6ES7531-7LH00-0AB0**)
16 ingressi con range di misura 1..5V, ±1V, ±5V, ±10V; risoluzione 16 bit

Per entrambi i codici, il connettore frontale deve essere ordinato a parte e può essere liberamente scelto con morsetti a vite o push-in.

Tutti i nuovi moduli I/O ad alta densità di canali – digitali e analogici - possono essere utilizzati sia sul **rack centrale** di una **CPU S7-1500** sia su **configurazione decentrata ET 200MP PROFINET** o **PROFIBUS**, in TIA Portal V16 oppure utilizzando il file GSD.

L'ultima novità riguarda il **bus di backplane attivo**, che garantisce un'alta disponibilità del sistema I/O permettendo l'**hot-swapping** dei moduli sul rack: oltre alla versione con 12 slot, già rilasciata qualche mese fa, sono ora disponibili anche le versioni da **4** e **8 slot**:

Active backplane bus 1 + 4 slot	**6ES7590-0BD00-0AA0**
Active backplane bus 1 + 8 slot	**6ES7590-0BH00-0AA0**
Active backplane bus 1 + 12 slot	6ES7590-0BL00-0AA0
Slot cover, packing unit = 5	6ES7590-0CA00-0AA0

Tutte le versioni del bus di backplane attivo possono essere attualmente utilizzate solo in **configurazione decentrata** su **PROFINET** con **IM 155-5 PN HF** (codice 6ES7155-5AA00-0AC0), firmware 4.4.1 (o successivo), in TIA Portal V16 o utilizzando il file GSD.

Link utili:
ET 200MP manual collection: https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/86140384
HSP TIA Portal: https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/72341852
Download PROFINET GSD ET 200MP: https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/68189683

Product Manager SIMATIC ET 200

SIMATIC ET 200MP Video